

CEI 60749-22
(Première édition – 2002)

**DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –
MÉTHODES D'ESSAIS MÉCANIQUES
ET CLIMATIQUES –**

Partie 22: Robustesse des contacts soudés

IEC 60749-22
(First edition – 2002)

**SEMICONDUCTOR DEVICES –
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS –**

Part 22: Bond strength

C O R R I G E N D U M 1

Page 6

Au lieu de:

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2012.

lire:

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.

Page 7

Instead of:

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2012.

read:

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.